

Reference 2

Partial Translation:

Japanese Patent Application laid open No. H01-199476

Title of the invention: Pressure Sensor

Application No.: S63-247073
Filing Date : September 30, 1988
Publication Date: August 10, 1989
Inventor : Aki TABATA et al.,
Applicant : Komatsu Ltd.

[Part A]

(5) As shown in Fig. 2(e), in order to protect a strain gage, resistors and wiring patterns, SiN_x membranes whose thickness is approximately 5000 Å are laminated as passivation layers by use of a plasma CVD technique.

[Part B]

Description of Numerals in the drawings

- 1: diaphragm
- 2: SiO_2 membrane
- 3: strain gage
- 4: electrode
- 5: sensor part
- 6: passivation membrane
- 7: temperature compensation part
- R: resistor
- E: wiring pattern
- Tr: transistor

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

平1-199476

⑬ Int. Cl.

H 01 L 29/84
G 01 L 9/04

識別記号

101

庁内整理番号

B-7733-5F
7507-2F

⑭ 公開 平成1年(1989)8月10日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

⑮ 発明の名称 圧力センサ

⑯ 特願 昭63-247073

⑰ 出願 昭63(1988)9月30日

優先権主張 ⑮ 昭62(1987)10月28日 ⑯ 日本 (JP) ⑰ 特願 昭62-272590

⑮ 発明者	田畠 亜紀	神奈川県平塚市万田1200	株式会社小松製作所研究所内
⑯ 発明者	田近 淳	神奈川県平塚市万田1200	株式会社小松製作所研究所内
⑰ 発明者	稲垣 宏	神奈川県平塚市万田1200	株式会社小松製作所研究所内
⑮ 発明者	小林 諭樹夫	神奈川県平塚市万田1200	株式会社小松製作所研究所内
⑯ 発明者	鈴木 朝岳	神奈川県平塚市万田1200	株式会社小松製作所研究所内
⑮ 出願人	株式会社小松製作所	東京都港区赤坂2丁目3番6号	

明細書

1. 発明の名称

圧力センサ

2. 特許請求の範囲

(1) ダイヤフラム受圧面の裏側に、絶縁膜を介して圧ゲージを設けている薄膜圧力センサにおいて、前記圧ゲージ形成面に圧ゲージと同材料で形成されている温度、零点等の補償の抵抗回路を設けたことを特徴とする圧力センサ。

(2) ダイヤフラム受圧面の裏側に、絶縁膜を介して圧ゲージを設けている薄膜圧力センサにおいて、ダイヤフラムの拘束面とダイヤフラム受圧面とに段差を設けたことを特徴とする圧力センサ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

半導体に圧を加えると大きな抵抗変化を示すというピエゾ効果を利用した半導体圧ゲージを用いて、各種のセンサが開発されている。

その1つとして、ステンレスなどの金属でダイヤフラムを構成し、このダイヤフラム上に絶縁膜

を介してアモルファスシリコン薄膜等の半導体薄膜からなる圧ゲージを形成した薄膜圧力センサがある。

本発明は、前記薄膜圧力センサの圧ゲージの温度あるいは零点を補償する回路において、その抵抗素子を圧ゲージと同材料で形成した補償回路の構造と圧力センサの受圧部と拘束部を遠ざけ拘束による受圧部への悪影響を少なくする構造に関するものである。

(従来の技術)

薄膜圧力センサについて説明する。

第6図(2)に、薄膜圧力センサの断面図を示すように、薄膜圧力センサは、ステンレス製のダイヤフラム1と該ダイヤフラム1の裏面に絶縁膜としての酸化シリコン(SiO₂)膜2を介して形成された多結晶シリコン層バターンからなる圧ゲージ3と、該圧ゲージ3に給電するためのアルミニウム層バターンからなる電極4と、圧ゲージ3と電極4とからなるセンサ部5を被膜保護するための窓化シリコン層からなるバッシベーション膜

特開平1-199476(2)

6 とから構成されている。そして同図 (b) に示すように、センサ部 5 は 4 つの歪ゲージ 3 のバターン $R_1 \sim R_4$ とこれらに給電するための 6 つの電極 4 の配線バターン $E_1 \sim E_6$ とから構成されている。このセンサ部 5 を等価回路で示すと、同図 (c) に示すように、ブリッジ回路を構成しており、圧力に起因した歪による歪ゲージ 3 の抵抗変化によって生じる電極配線バターン E_1 と E_2 との間の電圧変化を検出することにより、圧力を測定するようになっている。

ところで、半導体素子には、特性の温度依存性が大きいという欠点がある。しかし温度に対する繰り返し再現性は優れており、補償後はこの特性が逆に素子の信頼性を高める結果になっている。半導体薄膜圧力センサの場合、歪ゲージの抵抗値は該歪ゲージの固有の抵抗値と、圧力による抵抗の変化とともに、温度で変化する。従って歪ゲージを組みあわせたブリッジ回路では、圧力感度と零点とが、ともに温度によって変化してしまう。温度補償をいかに上手に行うかで圧力センサの精

(b) に示すように、トランジスタを介してセンサ部に印加される電圧が高くなっている (ロ)。センサ部に印加される電圧が高くなると温度によるセンサ部の感度低下分と相殺され、結局温度が上昇しても一定な感度を保つことができる (第 8 図 (a) (ロ))。このように温度補償用の素子を組み込んだ薄膜圧力センサは温度によって感度が変化しない信頼性の高いものとなる。

このような温度補償用の素子は、第 9 図に示すように薄膜圧力センサの外部に組み込まれている。薄膜圧力センサ 100 はケース 101 に組み込まれ、そのケース 101 と共に外部回路用のケース 102 に組み込まれる。同ケース 102 の内部にはアンプ 105 と温度補償用素子 106 が接続されたプリント基板 104 があり、同ケース 102 は蓋 103 によって閉じられている。プリント基板 104 上の温度補償用素子 106 によって温度補償された薄膜圧力センサ 100 の出力は、アンプ 105 によって増幅され、外部回路 (図示せず) に出力される。

度が決まるために、従来から種々様々な方法が試みられてきた。

次に示す方法は、定電圧駆動する圧力センサにおいて、トランジスタと抵抗を組み合わせて歪ゲージの感度の温度変動を相殺するものである。

第 7 図に温度補償用回路 7 を組み込んだ圧力センサの等価回路図を示すが、電極配線バターン $E_1 \sim E_6$ の接点と E_1 との間に、トランジスタ T_1 と抵抗 $R_1 \sim R_4$ とを接続する。

薄膜圧力センサの感度は、第 8 図 (a) に示すように、温度が高くなるにつれて直線的に低下してしまう (イ)。ここで感度とは、圧力センサが受ける圧力の大きさと、それによって生じる抵抗値の変化率である。つまり、

$$\text{感度} = \frac{\Delta (\text{抵抗値})}{\Delta (\text{圧力})}$$

となり、感度が高い方が精度が向上する。

いっぽう、温度補償に用いられているトランジスタの電圧降下は、温度が高くなるにつれて低くなる。つまり入力電圧を一定にしておけば第 8 図

また、従来はセンサモジュールを圧力変換器や他の被測定体に組み込む際、センサモジュールを拘束する位置は受圧面とほぼ同一面上にあった (第 5 図 (b))。

(発明が解決しようとする課題)

上記で説明した温度補償用の回路において、使用しているトランジスタの温度による電圧降下の変化率と、歪ゲージの温度による感度低下の変化率とは必ずしも一致しない。そこで、抵抗素子 $R_1 \sim R_4$ を 2 個用いて、その抵抗素子の 2 個の抵抗の比を変えることにより、前記電圧降下の温度依存性の値を自由に変えることができるので、歪ゲージの感度低下の変化率と一致させて、精度良く感度補正を行う。

従来この抵抗素子は、薄膜圧力センサの外部のプリント基板 104 に接続されていた。薄膜圧力センサは大きめの素子なので、プリント基板 104 にトランジスタとさらに抵抗素子 2 個をハンダ付けで接続したり、圧力センサの電極と接続したりするには困難であった。そして、抵抗素子 2 個を接

特開平1-199476 (3)

続するために、部品点数と工程が増えるということは、工程上の歩留り低下の要因、部品の不良や部品の接触不良等による歩留り低下の要因が大きく増えるということであった。

又、圧力センサを拘束し圧力を印加すると、拘束箇所の形状が変化し、第5図(c)に示すように拘束位置がずれる。従来のように拘束部が受圧面に近いと少しの拘束位置のずれでもダイヤフラム上の応力分布が大きく変化する(第5図(b))。この結果圧力に対する出力特性の直線性に悪影響を及ぼすという問題があった。

(課題を解決するための手段及び作用)

(1) 薄膜圧力センサの温度補償のための抵抗は、抵抗素子を用いて構成するのではなく、該薄膜圧力センサの歪ゲージを構成している材料を用いる。つまり、歪ゲージを形成する際、多結晶シリコン薄膜等を積層し、そしてパターニングを行うが、それと同時に、抵抗もパターニングして設ける。センサ部と抵抗との配線も、センサ部の電極配線バターンと同材料で同時に形成する。

E₊の接点と印加電圧源V_{in}(図示せず)との間に形成する。

第1図(d)に示すように、この実施例において、薄膜圧力センサは、ステンレス1上に絶縁膜としてSiO₂膜2を積層し、次に歪ゲージ3と抵抗R₁、R₂とを多結晶シリコン薄膜で形成し、その上に電極4の配線バターン(E₊～E₋)が形成されて構成されている。トランジスタT₁は、E₊～E₋間と、E₊、E₋とに外付けで接続される(図示せず)。この薄膜圧力センサの等価回路は第7図と同様である。

第2図(a)～(c)に本発明の第一の実施例の工程図を示し、説明する。

(1) 第2図(a)に示すように、ステンレスのダイヤフラム1上に、絶縁膜としてSiO₂膜をプラズマCVD法で約7μm積層する。

(2) 第2図(b)に示すように、該SiO₂膜上に多結晶シリコン薄膜をプラズマCVD法でシリカガスを原料に用いて約0.5μmの積層する。

(3) 第2図(c)に示すように、積層した多結

抵抗部を形成した多結晶シリコン薄膜等は、形状を任意にかえることにより、所望の抵抗値を得ることができ、従って、抵抗素子を用いることなく、トランジスタの電圧降下の温度依存性の値を歪ゲージの温度低下の変化率と一致させることができる。

(2) ダイヤフラム受圧面の裏側に絶縁膜を介して歪ゲージを設けている薄膜圧力センサにおいて、ダイヤフラムの拘束面とダイヤフラム受圧面とに段差を設けた、つまり拘束面を受圧面から遠ざけることにより、圧力印加時の拘束位置変化による影響が及ばなくなる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面に従って説明する。

始めに補償用抵抗に関して説明する。

第1実施例

第1図に本発明の第一の実施例の(a)平面図と、(b)断面図を示す。第1図(a)に示すように、ダイヤフラム1の歪ゲージ3(R₁～R₂)の形成面に、抵抗R₁、R₂を、電極配線E₊、

E₋の接点と印加電圧源V_{in}(図示せず)との間に形成する。

第1図(b)に示すように、この実施例において、薄膜圧力センサは、ステンレス1上に絶縁膜としてSiO₂膜2を積層し、次に歪ゲージ3と抵抗R₁、R₂とを多結晶シリコン薄膜で形成し、その上に電極4の配線バターン(E₊～E₋)が形成されて構成されている。トランジスタT₁は、E₊～E₋間と、E₊、E₋とに外付けで接続される(図示せず)。この薄膜圧力センサの等価回路は第7図と同様である。

尚、この抵抗バターン(R₁、R₂)は、歪を生じると抵抗値が変化してしまうので、一定の値を保つため、圧力によって歪を生じないダイヤフラムの周辺の位置に形成しなくてはならない。

(4) 第2図(d)に示すように、歪ゲージ(R₁～R₂)と抵抗(R₁、R₂)を形成した上に、アルミニウム(Al)等の金属電極4を蒸着し、フォトリングラフィ工程により配線バターン(E₊～E₋)を形成し、配線する。

(5) 第2図(e)に示すように、歪ゲージ、抵抗、配線バターンを保護するために、バッシャーション膜としてSiN_x膜をプラズマCVD法で500.0 Å程度積層する。

以上で、薄膜圧力センサは完成する。そして、

この薄膜圧力センサは第9図に示したと同様に、ケース101に組み込まれ、そのケース101と共に外部回路用のケース102に組み込まれる。同ケース102の内部にはアンプ105と温度補償用のトランジスタが接続されたプリント基板104があり、同ケース102は蓋103によって閉じられる。プリント基板104上のトランジスタと、薄膜圧力センサの電極E₁～E₄、E₅はボンディングワイヤ（図示せず）等で接続され、温度補償用回路は完成し、圧力センサの出力はアンプ105によって増幅され、外部回路（図示せず）に出力される。

このような構成の薄膜圧力センサにすることにより、温度補償用回路を構成する場合、部品、工程を増やすことなく、抵抗が形成できる。

本実施例は、感度に対する温度補償用の回路について説明したが、これに限ることなく、例えば零点に対する温度補償用の回路、各センサ間のバラツキによる零点補償用の回路等にも適用可能である。

第4図は本発明の第3の実施例の（a）平面図と（b）断面図である。温度補償素子を外部接続した場合の等価回路図は第2の実施例と同様（第3図（c））である。本実施例では第4図（a）に示すようにセンサ3（R₁～R₄）は実質長尺バターンなので抵抗が高く、これに伴って零点補償用抵抗R₅も高抵抗化する。従って本発明の第2の実施例のように、零点補償抵抗をくの字形などの実質幅広バターンにする必要はない。

又、本実施例では零点補償用粗調抵抗R₆をダイヤフラム1の中心に対して同一円周上に配置したので、感圧層成膜時の膜厚分布（ダイヤフラム中心が最も厚く外側に向かって薄くなる）を無視できる。そのため、複数個に区切られた粗調抵抗1個当たりの抵抗値のバラツキを低減でき、精度の良い補償ができる。

尚、本実施例では第4図（b）に示すように絶縁層2はS10₁一層であるが、ステンレスダイヤフラム1と絶縁層2の間に両者の線膨張係数の差を緩和するためのバッファ層として中間の線膨

第2実施例

第3図に第2の実施例として、感度に対する温度補償用の回路の抵抗R₁、R₂と、各センサ間のバラツキによる零点補償用抵抗R₃を、薄膜圧力センサのダイヤフラム上に形成した実施例の（a）平面図と（b）断面図と（c）温度補償素子としてトランジスタを外部接続した場合の等価回路図を示す。ダイヤフラム1上に、絶縁膜を積層し（図示せず）、その上にセンサ（R₁～R₄）と、感度に対する温度補償用の抵抗R₅、R₆と各センサ間のバラツキによる零点補償用回路の抵抗R₇として、多結晶シリコンを積層し、バターニングする。そしてAlなどの金属を積層しバターニングして、電極配線（E₁～E₅）を形成し、バッファーション膜（図示せず）を積層して薄膜圧力センサは完成する。本実施例ではE₁とE₂を結線し、その接点とE₅の電極から電圧を出力させることにより、R₅に零点粗調抵抗2個を、R₆に零点微調抵抗を加えたことになる。

第3実施例

張系数を持つ膜（例えばノンドープ多結晶シリコン膜0.3μm程度）を積層してもよい。

第4実施例

次に圧力センサの出力特性の直線性の改善に関して説明する。

第5図に圧力センサのダイヤフラム上の応力分布の拘束位置依存性を、（a）本発明によるダイヤフラム、（b）従来のダイヤフラム、について各々示している。

第5図（b）は従来のダイヤフラムの断面形状であり、拘束位置1aとダイヤフラム受圧部1bはほぼ同じ高さにあり、拘束部が①、②、③、④と少しその位置がずれることにより応力分布が大きく変わることを示し、第5図（a）は本発明のダイヤフラムの断面形状であり、拘束位置1aとダイヤフラム受圧部1bには段差が設けてあり、拘束位置1aとダイヤフラム受圧部1bは離れている。本発明の構造であると、拘束部が①、②とその位置がずれても応力分布に変化はない。

従って、圧力印加時、第5図（c）に示すよう

特開平1-199476(5)

に拘束位置がずれても、拘束部が受圧部に悪影響を及ぼさないので直線性は大幅に改善される。実施例では非直線性は約1/3に低減された(第5図(d))。

(発明の効果)

本発明の特許請求の範囲第1項の発明によれば補償用回路の抵抗をダイヤフラム上に歪ゲージと同材料で形成しているので、抵抗素子の部品点数を増やすことなく、また、ハンダ付等の工程数を増やすことなく、補償用回路の抵抗を構成することができる。そのため、ハンダ付等の工程中におこる不良、接触不良等による歩留り低下などの要因がなくなるため、歩留りは向上する。さらに、抵抗は歪ゲージと同材料で、同工程で形成されるので、薄膜圧力センサの工程を変えることなく、抵抗を形成することができるので、抵抗を形成することによっての工程の時間数は全く増加しない。

本発明の特許請求の範囲第2項の発明によれば圧力印加時に拘束位置がずれても、ダイヤフラムの応力分布に変化がなくなり、圧力センサの出力

特性の直線性が向上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明第1の実施例の薄膜圧力センサの(a)平面図と(b)断面図

第2図は同工程図

第3図は本発明第2の実施例の薄膜圧力センサの(a)平面図と(b)断面図(c)等価回路図

第4図は本発明の第3の実施例の薄膜圧力センサの(a)平面図と(b)断面図

第5図(a)は本発明による薄膜圧力センサのダイヤフラムの応力分布の拘束位置依存性を示すグラフ、第5図(b)は従来の薄膜圧力センサのダイヤフラムの応力分布の拘束位置依存性を示すグラフ、第5図(c)は圧力印加時のダイヤフラム拘束位置のずれを表す図、第5図(d)は本発明による直線性の改善を示すグラフである。

第6図は従来の薄膜圧力センサの(a)断面図と(b)平面図と(c)等価回路図

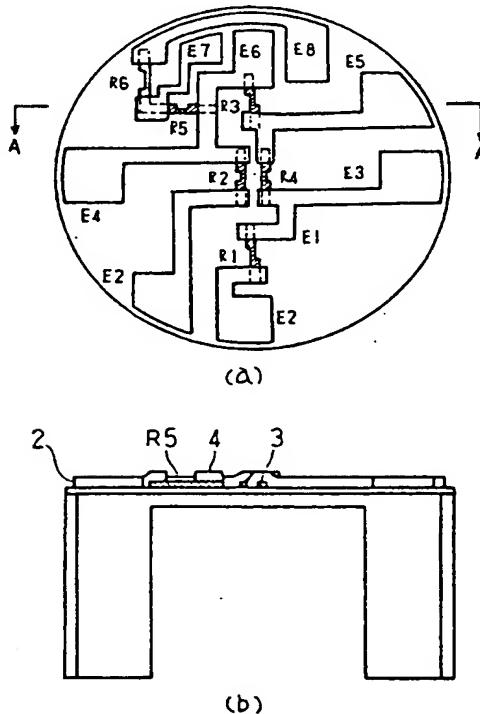
第7図は補償用回路を組み込んだ薄膜圧力センサの等価回路図

第8図(a)は薄膜圧力センサの感度と温度の関係を示す図、第8図(b)は温度補償用素子を介してセンサ部に印加される電圧と温度との関係を示す図

第9図は薄膜圧力センサと回路等をケースに組み込んだ図である。

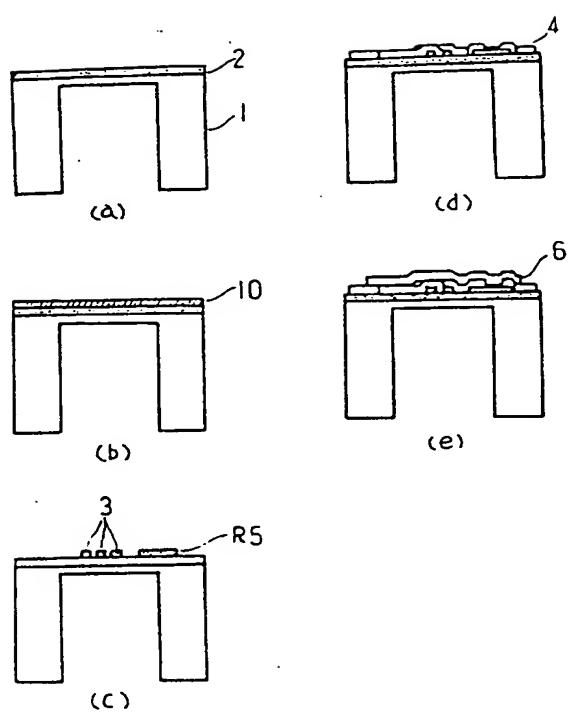
- 1 . . . ダイヤフラム 4 . . . 電極
- 1a . . . 拘束位置
- 1b . . . ダイヤフラム受圧部
- 2 . . . 絶縁膜 5 . . . センサ部
- 3 . . . 歪ゲージ
- 6 . . . バッシャーベーション膜
- 7 . . . 温度補償用回路
- 87 . . . 零点補償用の抵抗

出願人 株式会社 小松製作所

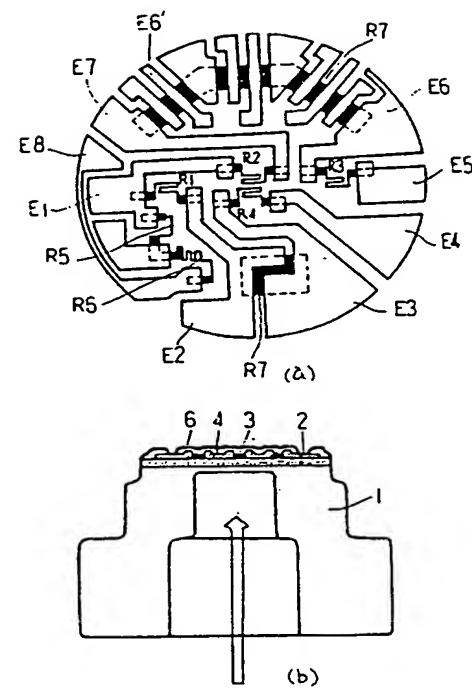


第1図

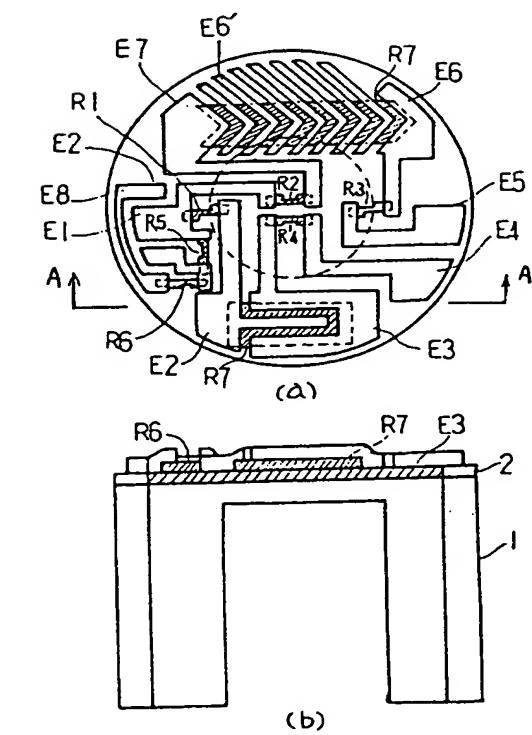
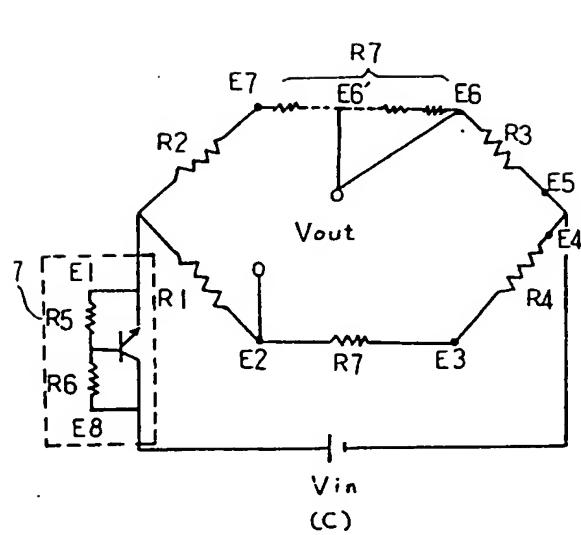
特開平1-199476 (6)



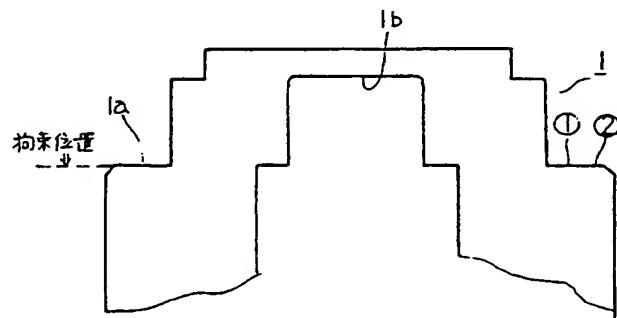
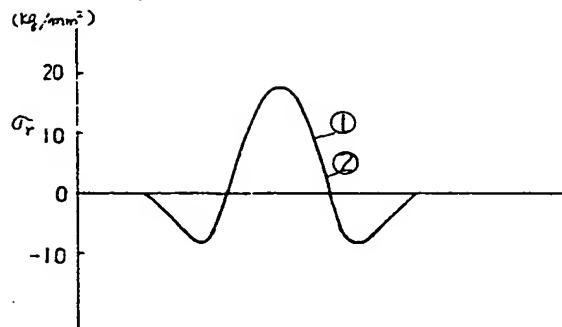
第2図



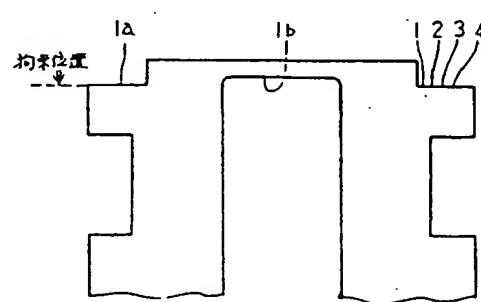
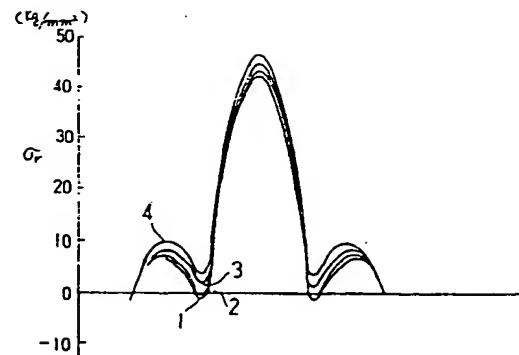
第4図



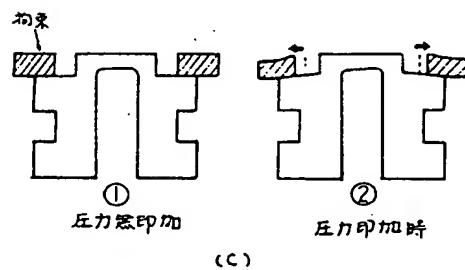
第3図



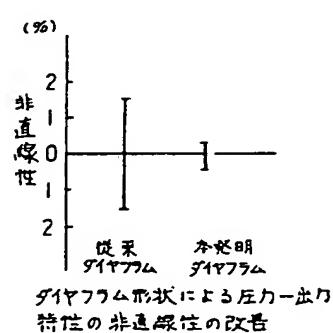
第5図 (a)



第5図 (b)



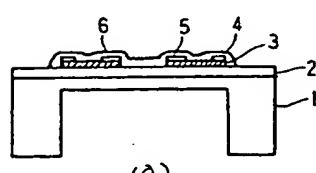
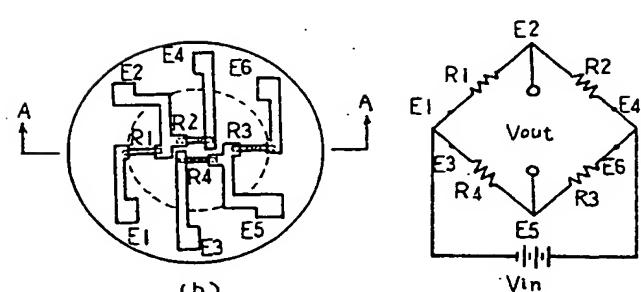
(c)



ダイヤフラン形状による圧力-出力
特性の非直線性の改善

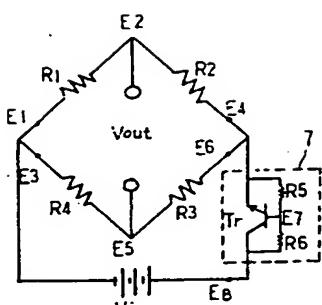
(d)

第5図

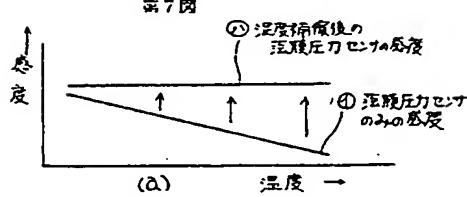


(a)

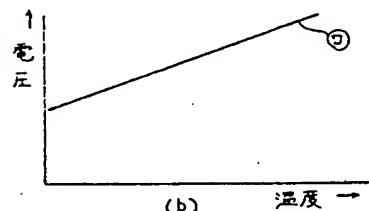
第6図



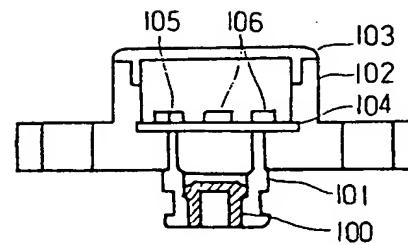
第7図



(a) 湿度 →



第8図



第9図